

53927-5010
ENG. No.

| | | | |
|--|--|-----------|-------------------------------------|
| 材料 MATERIAL | | SEE NOTES | MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 |
| 仕上げ FINISH | | SEE NOTES | |
| 適用電線範囲 WIRE RANGE | | — | REVISE ONLY ON CAD SYSTEM |
| 被覆外径 INS. RANGE | | — | TITLE 名称 |
| CFA CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (REVERSE TYPE) | | | DWG. NO. SHEET 1 OF 2 REV |
| SD-53927-5010 | | | 0 |

| | |
|---------------|-------|
| 角度 ANGLE | ±3° |
| 30以上 OVER | ±0.3 |
| 10以上 未満 UNDER | ±0.25 |
| 10未満 UNDER | ±0.2 |

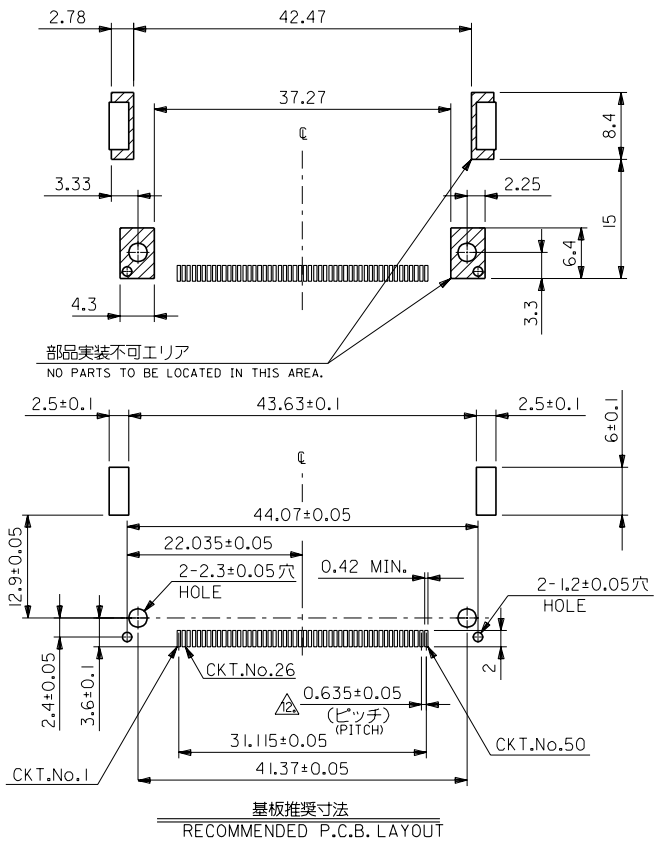
| | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|----------|
| 新規作成 RELEASED | 4.070244 | 1.0 | M.S | 96/06/30 |
| 記号 LTR | 変更内容 | DR | CHK | DATE |

DRAWN BY *S. Arizawa* CHK'D BY *H. Sakai*
APP'D BY *S. Arizawa* 尺度 SCALE 2-1

DWG. NO. SD-53927-5010

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

- 注)
 NOTES 1. 材質
 MATERIAL
 ハウジング：ガラス入りLCP UL94V-0
 HOUSING: LCP G.F. UL94V-0
 ピン：リン青銅
 PIN: PHOSPHOR BRONZE
 ネール：リン青銅
 NAIL: PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様
 PLATING
 PIN 接点部：パラジウムニッケル下地、金メッキ
 CONTACT AREA: Au OVER Pd-Ni
 半田付け部：半田メッキ
 SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD
 下地メッキ：ニッケルメッキ
 UNDERPLATING: NI OVER ALL
- NAIL 半田メッキ
 Sn-Pb
 下地メッキ：銅メッキ
 UNDERPLATING: Cu OVER ALL
3. 推奨基板厚：t 0.8 MIN.
 RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: t 0.8 MIN.
4. 適合カード厚
 RECOMMENDED CARD THICKNESS
 接続部：3.3±0.1
 CONNECTING AREA: 3.3±0.1
5. 適合カード幅：42.8±0.1
 RECOMMENDED CARD WIDTH: 42.8±0.1
6. ハウジング色：白
 HOUSING COLOR: WHITE
- △寸法適用極：1,13,38,50
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS
 1,13,38 AND 50.
- △寸法適用極：25,26
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 25 AND 26.
 ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ0.1 MAX.とする。
 PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1
 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.
- △ピン根元に適用する。
 THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.
 ソルダータールは、Z面を基準とし上へ0.05下へ0.2の範囲にあり、
 且つソルダータールの平坦度は、0.15 MAX.とし、タール先端にて測定する。
 SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND
 0.2 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF
 SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.15.
 MEASUREMENT POINT IS SOLDER TAILS TIP.
- △公差非累積
 NON-CUMULATIVE



基板推奨寸法
 RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|------------------|-------------------|----------------|--|
| 角度 ANGLE | ±3° | | | 材料 MATERIAL | — | MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 |
| 30以上 OVER | ±0.3 | | | 仕上げ FINISH | — | |
| 10以上 未満 OVER 30 UNDER | ±0.25 | | | 適用電線範囲 WIRE RANGE | — | TITLE 名称 |
| 10未満 UNDER | ±0.2 | 0 | SEE SHEET 1 OF 2 | 被覆外径 INS. RANGE | — | CFA CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (REVERSE TYPE) |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | | | | DRAWN BY 95/08/30 | CHK'D BY | DWG. NO. SHEET 2 OF 2 REV |
| | | | | APPR'D BY | 尺度 SCALE 2 - 1 | SD-53927-5010 0 |

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32